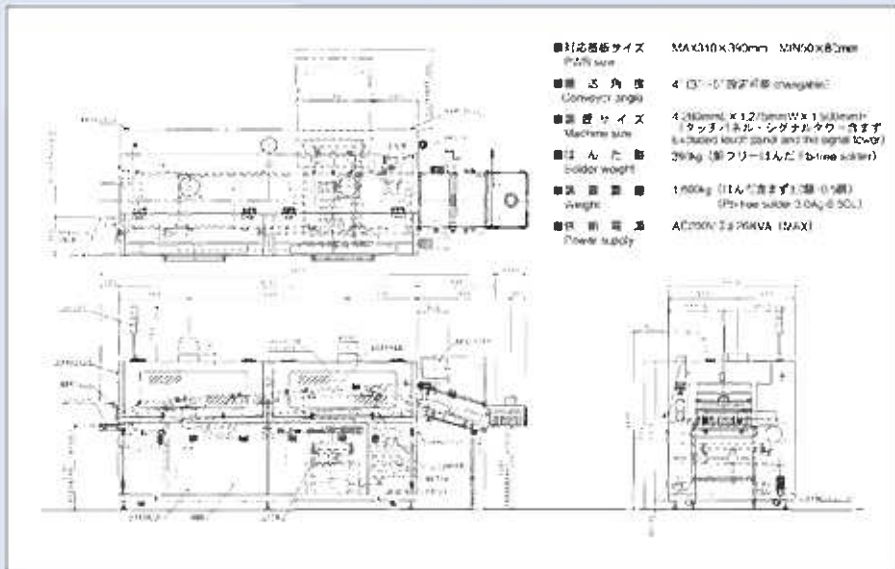


装置基本仕様 [Machine Specifications]



- 対応基板サイズ
PCB size: MAX310×190mm MIN50×80mm
- 搬送角度
Conveyor angle: 4° (30°の選定も可能)
- 搬送サイズ
Machine size: 4.140mm (X) × 1.275mm (Y) × 1.610mm (Z)
タクト: 1スル/1分 (シングルタクト) / 1.5分 (2スル)
39kg (Pbフリーはんだ1.5分用)
- はんだ
Solder weight: 1.500kg (1.1kg (1分用) / 0.500kg (Pb-free solder 3.0分用))
- 電源
Power supply: AC100V 2.50kVA (2FA)

標準装備 Standard Installation

- ・酸化処理 (ノズル、ダクト)
Surf coating (Nozzle & Duct)
- ・酸素濃度計
Oximeter
- ・入ロビン付チェーンコンベヤー
Inlet chain conveyor with pin
- ・フラックスフーム回収装置
Flux fume collector
- ・樹脂溜
Resin Tagger

オプション Option

- ・はんだ自動供給装置
Automatic wire solder feeder
- ・はんだ自動供給装置
Automatic bar solder feeder
- ・基板反り防止
Anti-warp holder
- ・内部照明
Interior light
- ・酸素濃度自動調整機能
O2 density auto adjust function
- ・基板停滯、落下検知
Stagnation detection and the fall detection of the circuit board

OSAKA ASAHI CHEMICAL CO., LTD.



URL <http://www.osaka-asahi.co.jp>

本社 〒564-0663 大阪府吹田市江坂町2-1-43 KYUHO江坂ビル5F TEL 06-6338-1961 FAX 06-6330-7361
 名古屋 〒465-0026 愛知県名古屋市長区藤森2-243 TEL 052-775-0051 FAX 052-775-7696
 福岡 〒815-0041 福岡市南区野間1-1-19 高宮駅前ビル502 TEL 092-561-3829 FAX 092-561-3811
 福岡製作所 〒701-2225 岡山県倉敷市山口2-22-3 TEL 086-957-2051 FAX 086-957-2451
 海外サポート拠点
 シンガポール TECH ASAHI SYSTEM SINGAPORE PTE LTD TEL 65-6325-4397 FAX 65-6325-4397
 10 Anson Road #20-02 International Plaza Singapore 079603
 マレーシア TECH ASAHI SYSTEM MALAYSIA SUN BHD TEL 60-3-7873-9200 FAX 60-3-7873-9400
 No.533, Block A2, Pusat Dagang SetiaJaya No.9, Jalan Padjad 46150 Mctaling Jaya Selangor Darul Ehsan Malaysia
 中国事務所 TECH ASAHI SYSTEM SINGAPORE CHINA OFFICE TEL/FAX 86-769-8544-3017
 中国広東省東莞市長安鎮新民二村順和路211号 (通和封蓋)

販売店 [Sales agent]

※このカタログに記載されている内容は改良のため予告なく変更することがあります 2009.1
 The details in this catalog are subject to alteration without notice for the purpose of performance improvement

高性能フルチャンバー式N2ソルダーリングマシン
N2 Soldering Machine

HD-310FN



特徴 Features

トレンドグラフ表示・CFカードに約1年分メモリ (はんだ温度、プリヒータ温度、酸素濃度、酸素流量、アラーム・生体検知)

安定した低酸素濃度 (400ppm以下) 達成。酸素濃度自動調整機能 (オプション)

Pbフリーはんだ使用対策に特選溶剤バス採用 (厚み15mm)

1S2Sノズル搭載選小、温度ドロップ対策 (スルホールUP良好、ポイド減)

ノズル外観調整機能 (1Sノズル、2Sノズル) 標準装備

100種類はんだ付け条件メモリー機能標準装備

高性能パネルプリヒータ3分割3制御標準装備

メンテナンスがしやすいフルオープン構造。はんだ箱自動上下引き出し収納標準装備

閉気環境による酸化物の発生削減。ランニングコストの削減。



■ハンダ温度、プリヒータ温度トレンドグラフ
Solder temperature / Pre-heat temperature



■酸素濃度・酸素流量トレンドグラフ
O2 density / N2 flow

OSAKA ASAHI CHEMICAL CO., LTD.

URL <http://www.osaka-asahi.co.jp>

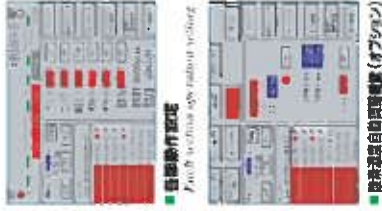
HD-310FN 新型フルチャパンバー式N2ノルダリングマシン

■ 高性能TFTタッチパネル機能

High performance TFT touch panel.
 ・週間タイマー設定、各動作タイムスライス、温度設定、速度表示、製菓履歴表示等(オプション)
 Weekly timer setting, Each section operation with temperature setting, Temperature indication, 12 density auto setting (option).

・トレンドグラフ表示(CFカーンにハンダは付、プリヒータ温度、製菓温度、空焚流量、アラーム、生産履歴を約1年メモリ)
 Trend graph, CF card with Solder temperature, Pre-heater temperature, Bake temperature, Alarm history, Production history for 1 year memory.

・ハンダ付け条件100種類メモリ
 15S/2S温度、プリヒータ温度、搬送スピード、15S/2S温度メモリ。
 Solder to impedance, pre-heater temperature, transport speed, 15S/2S temperature memory. Solder bath height.



■ 各種動作履歴
Each section operation history

■ 製菓温度履歴表示
Bake temperature history

■ 温度履歴表示
Temperature history

■ 生産履歴表示
Production history

■ 温度履歴表示
Temperature history

■ 生産履歴表示
Production history

■ 温度履歴表示
Temperature history

■ 生産履歴表示
Production history

■ 温度履歴表示
Temperature history

■ 生産履歴表示
Production history

■ 温度履歴表示
Temperature history

■ 生産履歴表示
Production history

■ 温度履歴表示
Temperature history

■ 生産履歴表示
Production history

■ 温度履歴表示
Temperature history

■ 生産履歴表示
Production history

■ 温度履歴表示
Temperature history

■ 生産履歴表示
Production history

■ 温度履歴表示
Temperature history

■ 生産履歴表示
Production history

■ 温度履歴表示
Temperature history

■ 生産履歴表示
Production history

■ 温度履歴表示
Temperature history

■ 生産履歴表示
Production history

■ 温度履歴表示
Temperature history

■ 生産履歴表示
Production history

■ 温度履歴表示
Temperature history

■ 生産履歴表示
Production history

■ ハンダ槽部

Solder bath sec.
 ・安定した低酸素濃度(400ppm以下)達成
 Stable low O2 atmosphere (under 400ppm)
 ・Pbフリーはんだ適合対応…厚み15mm特殊鉄物(SHC)採用
 No-lead solder with SHC bath with 15mm thickness.
 For prevention of Pb-free solder erosion.

・ハンダ槽電動上下(エンコーダ制御)引き出し収納標準装備
 Solder bath auto movement (Encoder control).
 ・ヒートメンテナンス…ハンダを抜かずに、ノズル、ダクト取り外し可能
 Single auto heater… Possible to remove nozzle & duct with solder in bath.

・1Sと2S間の温度ドロップ少なく、スルホールUP良好、ボイド減少
 No-lead solder with SHC bath with 15mm thickness.
 For prevention of Pb-free solder erosion.
 ・間欠噴流(5分間稼働後が短い場合噴流停止)でハンダ消費量削減
 Intermittent wave solder (solder consumption).
 (Stop when the PW is over-cycled for 5 minutes).



■ 1S/スルホールノズル
 Good bonding of fine pins / no-lead solder.
 プリアリーはんだスルホール上がり良好
 Good solder free.



■ 2S/スルホールノズル
 Easy solder bridges.
 ハンダフレイレットIP
 Solder filter use.



■ バックプレート調整レバー
 Easy plate adjustment.
 ■ センタープレート調整レバー
 Center plate adjustment.

■ 操作パネル



■ 特はんだ供給機(オプション)
 Solder for the special lead.



■ ヒューム回収ユニット標準装備
 Fume collection unit.

■ 高効率高性能プリヒーター

High performance pre-heater



■ パネルヒーター3分割制御標準装備
 Panel heater 3-part control.



■ 入ロビン内電子コンベア標準装備
 In-robotic conveyor (option) standard.



■ 製菓温度カウンター標準装備
 Counter for bake temperature is available.



■ 高性能TFTタッチパネル採用
 High performance TFT touch panel.



■ 製菓温度計・N2濃度調整機
 Bake temperature meter / N2 flow adjuster.

